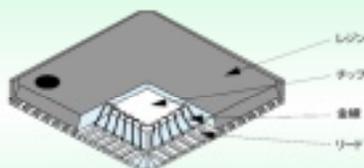


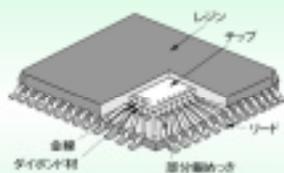
後工程 映像教材

CD-ROM (Flash)

半導体後工程 -プロセスフロー-
QFN, QFP等のリードフレーム品



QFN :
Quad Flat Non-leaded Package



QFP :
Quad Flat Package

半導体後工程製造フローの概略

本教材は、株式会社 人財ソリューションが
半導体後工程製造フローの概略を
まとめたものです。

ナレーションは、合成音声を使用しています。

販売 (有) セミコンブレン

<http://www.semiconbrain.com/>

半導体後工程 -プロセスフロー-

QFN、QFP等のリードフレーム品

1.ウエハー加工

①クリーンルーム 画像サンプル

②ウエハー受入

③ウエハーマウント

④ダイシング

⑤UV照射

⑥ウエハービジュアル

2.アセンブリ加工

D.B.~W.B.

⑦ダイボンディング

⑧ベークキュア

⑨ワイヤーボンディング

⑩アセンブリビジュアル

3.アセンブリ加工

モールド~切断成形

⑪モールド

⑫モールドベーク

⑬マーク

⑭メッキ

⑮切断成形

4.テスト

⑯挿抜機

⑰バーンイン

⑱テスト

⑲スキャナー

⑳テーピング

㉑梱包

SKIP>>

ウエハー加工

①クリーンルーム



ウエハー加工

①クリーンルーム



ウエハー加工

①クリーンルーム



ウエハー加工

②ウエハー受入



ウエハー加工

②ウエハー受入



ウエハー加工

②ウエハー受入



ウエハー加工

③ウエハーマウント



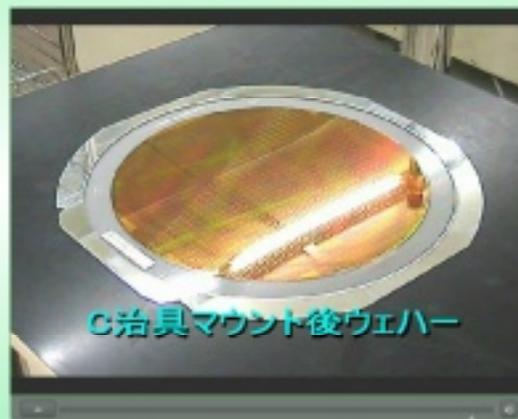
ウエハー加工

③ウエハーマウント



ウエハー加工

③ウエハーマウント



ウエハー加工

④ダイシング



ウエハー加工

④ダイシング



ウエハー加工

④ダイシング



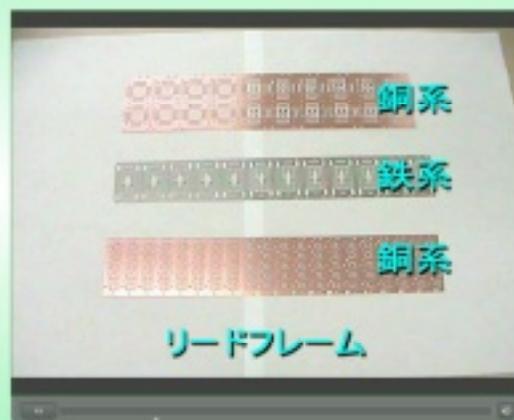
アセンブリ(1) DB~WB.

①ダイボンディング



アセンブリ(1) DB~WB.

①ダイボンディング



アセンブリ(1) DB~WB.

①ダイボンディング



アセンブリ(1) DB~WB.

①ダイボンディング



アセンブリ(1) DB~WB.

①ダイボンディング



アセンブリ(1) DB~WB.

①ダイボンディング

